

## لایه‌نشانی کندوپاش با کاتد مگنترون استوانه‌ای

صالحی، مریم<sup>۱</sup>؛ زواریان، علی اصغر<sup>۱</sup>؛ سیدمحمدجمال<sup>۱</sup>

<sup>۱</sup>جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، تهران

### چکیده

برای لایه‌نشانی داخل سطوح استوانه‌ای روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از بهترین آنها لایه‌نشانی کندوپاش با استفاده از کاتد استوانه‌ای است. در این پژوهش برای اولین بار با استفاده از یک کاتد کندوپاش استوانه‌ای جریان مستقیم با مگنترون ثابت، داخل یک استوانه از جنس استیل، لایه‌ای از مس با نرخ لایه‌نشانی ۳ نانومتر بر ثانیه نشانده شد. در این آزمایش از یک استوانه مسی با قطر مناسب به عنوان کاتد استفاده گردید. استوانه استیل در فاصله معین و هم‌مرکز با آن قرار داده شد. (متوسط میدان مغناطیسی اعمالی در مرکز استوانه در حدود ۲۰۰ گوس بوده است. فشار اولیه محفظه برابر  $6.7 \times 10^{-5}$  میلی‌بار و فشار گاز آرگون در طول آزمایش ثابت و برابر  $1.1 \times 10^{-2}$  میلی‌بار بود.)

در این مقاله ابتدا فیزیک و عملکرد کندوپاش استوانه‌ای به اختصار بیان شده است. پس از آن روش آزمایش و نتایج تجربی لایه‌نشانی با استفاده از کاتد استوانه‌ای ساخته شده آورده شده و در پایان نتیجه‌گیری ارائه گردیده است.

## Thin Film Deposition by Cylindrical Sputtering Cathode

Salehi, Maryam<sup>1</sup>; Zavarian, Ali Asghar<sup>1</sup>, Ghotbi, S. M. Jamal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>ACECR, Sharif University Branch

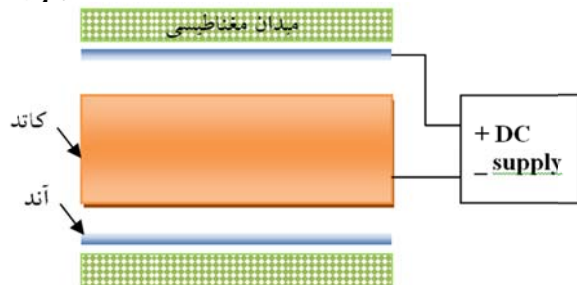
### Abstract

*There are some methods to deposit thin films on the internal walls of cylindrical bodies which the best of them is a cylindrical sputtering cathode. In this research, for the first time we have used a cylindrical un-cooled cathode with constant outside magnetron to deposit a thin copper film on the internal wall of a steel cylinder. The rate of deposition was 30 A/Sec. In this experiment, a cylindrical copper bar with suitable diameter used as the cathode and steel hallow cylinder concentric to it as the anode. The base pressure was  $6.7 \times 10^{-5}$  mbar and the Argon pressure constant at  $1.1 \times 10^{-2}$  mbar throughout the experiment. In this paper, first the physics of cylindrical sputtering is described in brief and then the experiment of thin film deposition by cylindrical magnetron cathode and its results are explained. Finally the conclusions are expressed.*

روش کندوپاش که در صنایع خودروسازی و نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد، لایه‌نشانی بر روی قطعات به منظور جلوگیری از خوردگی مکانیکی آنهاست که بخش مهمی از دانش فیزیک سطح است. به این منظور با ایجاد لایه نازکی از مواد مقاوم در برابر خوردگی مکانیکی مثل نیتريد تیتانیوم و تانتالیوم یا ترکیباتی از عناصر مختلف مثل  $Al_xSn_yCu$  بر روی قطعه موردنظر، مقاومت مکانیکی و طول عمر آنرا افزایش می‌دهند [۱].

### مقدمه

پیشرفت‌های گسترده‌ای که در فناوری ساخت لایه‌های نازک روی داده است باعث شده این فناوری در بخش‌های مختلف صنعت در مقیاس بیشتری مورد استفاده قرار گیرد. لایه‌نشانی به روش کندوپاش<sup>۱</sup> در خلأ یکی از روش‌هایی است که به علت خلوص و چسبندگی بالای لایه و کیفیت خوب آن، از اهمیت خاصی برخوردار است. از این روش در ایجاد ساختارهای نانویی، ساخت مواد ابررسانا، فیلترها و اجزای نوری<sup>۲</sup> و سایر زمینه‌های پژوهشی و صنعتی استفاده می‌شود. یکی دیگر از کاربردهای لایه‌نشانی به



شکل ۱: طرحواره کندوپاش استوانه ای

در شکل ۱ طرحواره ساده ای از کندوپاش استوانه ای با اعمال میدان مغناطیسی محوری در خارج زیرآیند نشان داده شده است. طول استوانه کاتد تاثیر کمی بر روی عملکرد آن دارد. در عوض فاصله کاتد و آند بسیار مهم است [۱ و ۲].

در این مقاله این نوع آرایه مغناطیسی طراحی و مورد استفاده قرار گرفت.

### چیدمان آزمایش و نتایج تجربی

در این پژوهش با طراحی و ساخت یک چیدمان آزمایشگاهی ساده و انجام آزمون های مختلف، لایه نشانی به روش کندوپاش مگنترون با استفاده از یک کاتد استوانه ای مسی، بر روی زیرآیند استوانه ای از جنس استیل انجام گرفت.

برای انتخاب فاصله مناسب بین کاتد و آند آزمایشات مختلفی انجام شد و در نهایت برای دستیابی به پلاسمایی با چگالی مناسب کاتد و آند به صورت زیر انتخاب شد.

کاتد یک میله مسی توپر به ارتفاع ۵۰ میلی متر و زیرلایه یک لوله استوانه ای از جنس استیل بود. قطر بیرونی مجموعه ۶۲ و ارتفاع آن ۵۰ میلی متر بود (شکل ۲، سمت چپ).



شکل ۲: اجزای زیرسامانه کندوپاش استوانه ای

برای ایجاد میدان مغناطیسی محوری در خارج زیرآیند، از یک مجموعه آهنربای دائمی استفاده شد. مجموعه آهنربا شامل یک آرایه از آهنرباها از جنس NdFeB با درجه N35 بود که درون یک

برای لایه نشانی روی زیرآیندهای مسطح<sup>۳</sup> از کاتد تخت استفاده می شود. اما این کاتدها برای ایجاد لایه روی سطوح داخلی اجسام استوانه ای مناسب نیستند، زیرا به علت اختلاف فاصله نقاط مختلف سطح زیرآیند از کاتد تخت، لایه نشانی به صورت یکنواخت صورت نمی گیرد. برای لایه نشانی بر روی این سطوح، از کاتد استوانه ای استفاده می شود مانند ساخت آینه های خورشیدی [۱-۳].

### فیزیک و عملکرد کندوپاش استوانه ای

مانند سایر روش های لایه نشانی فیزیکی تحت خلأ، روش کندوپاش نیز شامل جدا کردن یونهای ماده هدف<sup>۴</sup> از سطح آن و انتقال آن ها به زیرآیند و تشکیل لایه نازک روی آن است. در روش کندوپاش، با بمباران و برخورد یون های مثبت پر انرژی یک گاز نادر مانند آرگون به سطح هدف که دارای پتانسیل منفی است، اتم ها یا مولکول های آن از سطح جدا شده و به بیرون پرتاب می شوند. زیرآیند دارای ولتاژ مثبت بوده و در واقع نقش آند را داراست و لایه ای از جنس هدف روی آن انباشت می شود. برای لایه نشانی بر روی سطوح قوس دار و استوانه ای، کاتد باید به شکل استوانه طراحی شود. در این روش کاتد را هم محور با زیرلایه قرار می دهند.

به علت فشار کاری پایین محفظه که در محدوده  $10^{-2}$  میلی بار قرار دارد، استفاده از میدان مغناطیسی برای افزایش چگالی پلازما در مقابل سطح هدف الزامی است. روش های مختلفی برای اعمال میدان مغناطیسی وجود دارد، که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ایجاد میدان مغناطیسی چندصد گاوسی در سطح هدف با استفاده از عبور جریان بالا از یک سیم مسی که از داخل هدف استوانه ای می گذرد.
- ایجاد چند قطبی مغناطیسی با استفاده از آهنربا در داخل و یا خارج هدف.
- ایجاد چند قطبی مغناطیسی با استفاده از آهنربا در خارج زیرآیند.
- ایجاد میدان مغناطیسی قوی با استفاده از یک آرایه استوانه ای آهنربای دائمی یا الکتریکی در فضای خارج زیرآیند [۱-۳].



شکل ۴: محفظه لایه نشانی در آغاز فرآیند

### نتیجه گیری

در این آزمایش علیرغم نبود سامانه خنک‌سازی، گرمای ایجاد شده در کاتد و اختلال حاصل از آن، مانع از کارپوسته کاتد نبود. با طراحی بهینه آرایه مغناطیسی بازدهی، نرخ لایه‌نشانی و چسبندگی لایه در حد قابل قبولی بدست آمد. به علاوه در این پژوهش تأیید شد که فاصله کاتد و آند در تشکیل پلاسما و بازدهی سامانه نقش اساسی دارد. در نهایت باید اضافه کرد که برای استفاده در توان‌های بالاتر و کارایی بیشتر طراحی آبگرد و تعیین فاصله بهینه کاتد و آند اجتناب ناپذیر است.

### مرجع‌ها

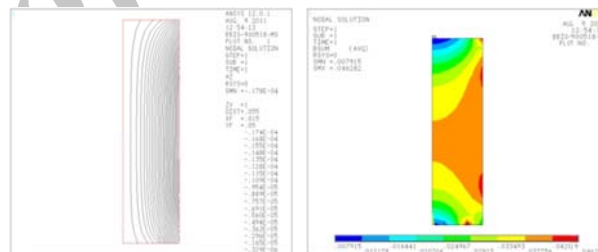
[1] Bhavin Shah, "Deposition of Tantalum on Steel by Sputtering", MS Thesis, New Jersey Institute of Technology.

[2] David A. Glocker & et al. "Recent developments in inverted cylindrical magnetron sputtering", Surface and Coatings Technology 146-147 (2001).

[3] ضرغام اسداللهی، پروین بلاش آبادی، عبدالجواد نوینروز، محمد رضا قاسمی، طراحی و ساخت دستگاه کندوپاش مغناطیسی جریان مستقیم با دو تارگت استوانه‌ای « هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی (۱۳۸۵) »

قاب مناسب در ۱۲ ردیف قرار داده شدند (شکل ۲، سمت راست). شدت میدان مغناطیسی قبل و بعد از انجام آزمایش در چند نقطه در اطراف این مجموعه با استفاده از تسلامتر اندازه‌گیری شد. مشاهده گردید که علیرغم افزایش قابل توجه دمای مجموعه آهنرباها، تغییری در شدت میدان آن ایجاد نشد. مقدار بیشینه شدت میدان روی سطح آهنرباهای بالا ۱۱۱۰ گاوس بود.

برای انتخاب این آرایه، میدان مغناطیسی مجموعه با استفاده از نرم افزار ANSYS شبیه‌سازی شد. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که روی محور استوانه آند، کمینه چگالی شار مغناطیسی حدود ۷۹ گاوس و بیشینه آن نیز بیش از ۳۷۷ گاوس است. اندازه‌گیری با تسلامتر بر روی قطعه ساخته شده مقدار این کمیت را بیش از ۲۰۰ گاوس نشان داد که با متوسط مقادیر شبیه‌سازی شده هم‌خوانی داشت. مجموعه کاتد و زیرلایه به صورت هم‌محور داخل این آرایه مغناطیسی و کل مجموعه بر روی صفحه کار سامانه خلأ قرار داده شدند (شکل ۳).



شکل ۳: راست: نمایش کانتوری چگالی شار مغناطیسی چپ: نمایش کانتوری خطوط شار در مدل آهنربای دائمی و در فضای درونی آند

برای ایجاد خلأ نهایی ( $6.7 \times 10^{-6}$  mbar) از سامانه خلأ بالای EDS100 مجهز به پمپ انتشاری<sup>۱</sup> استفاده شد (شکل ۴). فشار کار توسط جریان گاز آرگون در محدوده  $10^{-2}$  میلی‌بار تنظیم گردید. از یک منبع تغذیه جریان مستقیم ۱ کیلوولت برای ایجاد تخلیه الکتریکی، استفاده شد. در فشار  $1/1 \times 10^{-2}$  ولتاژ منبع تغذیه در محدوده ۵۰۰ ولت تنظیم گردید. با تغییر رنگ پلاسما از بنفش به سبز، لایه نشانی آغاز و با نرخی در حدود ۳ نانومتر بر ثانیه ادامه یافت. پس از ۱۵ دقیقه لایه‌نشانی در حالت نسبتاً پایدار، لایه‌ای به ضخامت ۲/۷ میکرون ایجاد شد.

<sup>1</sup>Sputtering

<sup>2</sup>Optical Components

<sup>3</sup>Planar Substrates

<sup>4</sup>Planar Cathodes

<sup>5</sup>Target

<sup>6</sup>Diffusion